

## INVESTOR RELATIONS

20년 3분기

Your Most trustworthy



## 유의사항 [Disclaimer]

본 자료는 한국채택국제회계기준 연결실적에 대한 경영실적 및 재무성과를 바탕으로 작성되었습니다.

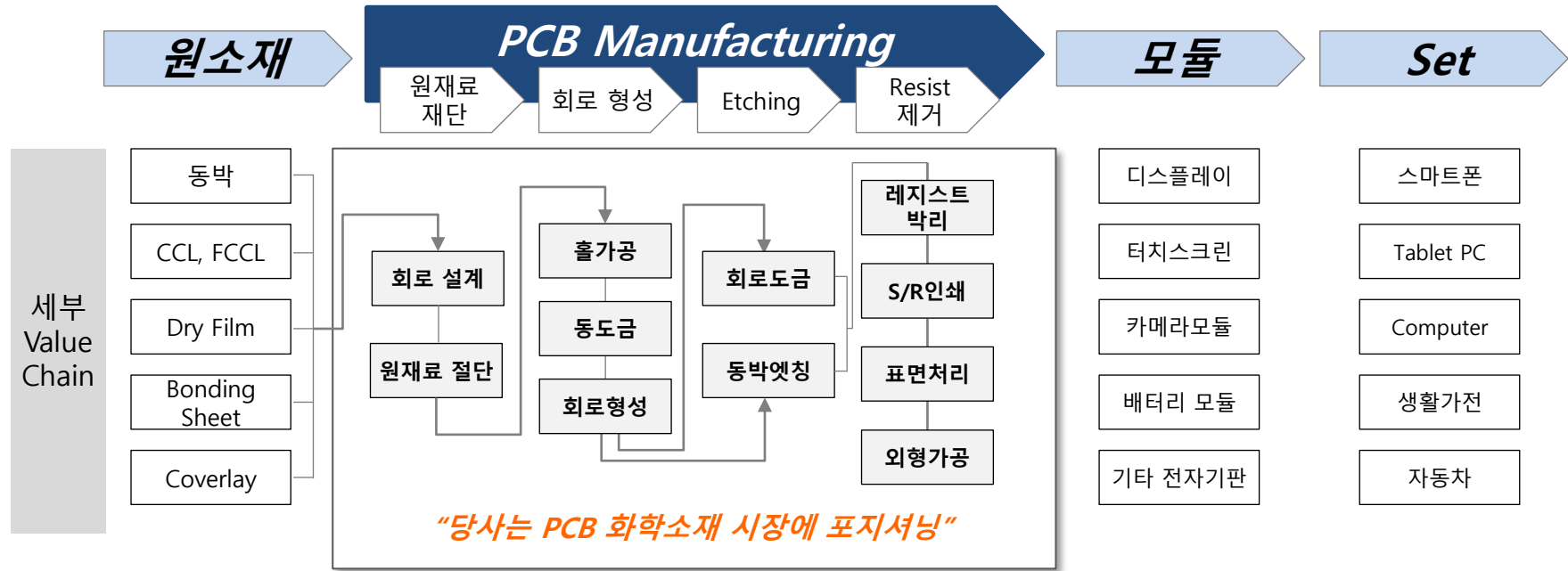
또한 본 자료는 미래에 대한 "예측정보"를 포함하고 있으며, 이러한 "예측정보"는 향후 경영환경의 변화 등에 따라 불확실성으로 인하여, 실제 경영현황 및 재무실적에 긍정적 또는 부정적으로 영향을 미칠 수 있습니다.

- 국내외 국가정책변경에 따른 세율 변동 (FTA, 관세, 법인세 등)
- 환율 및 이자 변동을 포함한 국내외 금융시장의 동향
- 주요 매출시장의 환경의 예상치 못한 급격한 변화
- 회사내의 전략적인 의사결정

이러한 불확실성으로 인해 회사의 실제 미래실적은 "예측정보"에 기재되거나 암시된 내용과는 중대한 차이가 있을 수 있습니다.



PCB Industry value chain



당사의 주요 포지셔닝은 PCB 화학소재이며 특히 부가가치가 높은 최종표면처리 및 화학동도금 Segment에서 주요 매출이 발생되고 있습니다.

주요고객사 (Major Customer)

*“주로 한국, 중국, 대만의 FPCB 회사들이 주요 고객사이며, 최근 한국의 PKG Substrate 제조사로 고객사 확대중”*

FPCB Customer				
				
				
PKG Substrate				

## Total Solution for Customer

와이엠티는 공정의 첫 단계인 세정, 박리제 부터 최종 표면처리 까지의 모든 화학소재 기술을 보유하고 있습니다. 이에 저희는 고객사 설비 특성에 맞는 Total chemical solution을 제공하고 있습니다.



### Final Finishing Chemical

#### **Soft ENIG Process**

- ✓ CF 300 Series
- ✓ MIKO Series

#### **ENIG Process**

- ✓ PEN Series
- ✓ MIKO Series

#### **ENEPIG Process**

- ✓ PEN Series
- ✓ ELP or ZEP Series
- ✓ IR Gold Series

#### **EPIG process**

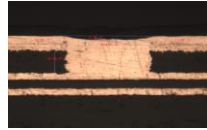
- ✓ ZEP Series
- ✓ IR Gold Series

#### **Immersion process**

- ✓ PROTIN Series

#### **Electrolytic gold process**

- ✓ HG 300 series
- ✓ SAU 10 series



### Copper plating chemical

#### **Electroless Copper plating**

- ✓ HVF Series
- ✓ MJH series

#### **Electrolytic Copper plating**

- ✓ BJ series
- ✓ HBJ Series(Half-fill)
- ✓ FSBJ Series(flash plating)
- ✓ ZEUS Series(Via-fill)



### Process Chemical

#### **DES Chemical**

- ✓ MSAP/SAP DFR Stripper
- ✓ MSAP/SAP Cu seed Etchant
- ✓ GMZ Series
- ✓ HWA Series

#### **Cleaner**

- ✓ FXC Series
- ✓ EQ Series

#### **Gold Recover**

#### **UBM Etchant**

#### **LAZ Process**



### New product for 5G

#### **No etching and roughness laminating pretreatment**

#### **Ultra low profile detachable thin copper foil**

#### **Positive Cu roughening**

#### **Process Nanotus®**

#### **Electroless Copper plating for LCP**

Domestic Market situation

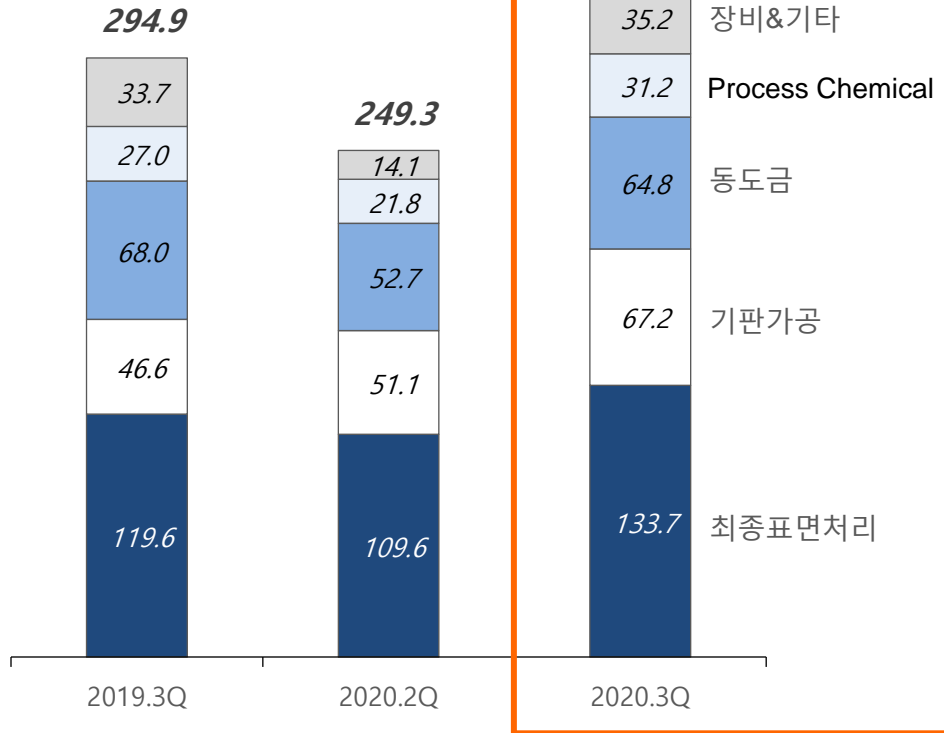
신규 사업분야  
기존 사업분야

		"기존 사업영역" FPCB, RFPCB		"20년 신규진입분야" PKG		HDI		RIGID	
Major player	Domestic	<ul style="list-style-type: none"> <li>SEMCO</li> <li>BH Flex</li> <li>Youngpoong</li> <li>Daeduck</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>SEMCO</li> <li>Daeduck</li> <li>SIMTECH</li> <li>Korea Circuit</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Daeduck</li> <li>LG Innoteck</li> <li>Korea Circuit</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hyunwoo</li> <li>SEIL</li> </ul>				
	Global	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zhending Technology</li> <li>Career</li> <li>Unimicron</li> <li>Mektron</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>AT&amp;S</li> <li>Zhending Technology</li> <li>Ibiden</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>AT&amp;S</li> <li>Zhending Technology</li> <li>Ibiden</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Various</li> </ul>				
Process Chemical		<ul style="list-style-type: none"> <li>점유율 확대중</li> <li>Fine pattern 용 고부가가치 박리액 등 프로모션</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>고객사 및 라인 확대중</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>박리 / 에칭 관련 매출 확대중</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> </ul>				
Cu Plating	Electroless	<ul style="list-style-type: none"> <li>국내 높은수준의 점유율 보유 (40% 이상 추정)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>현재 자회사 외주를 통한 매출발생중</li> <li>4분기 고객사 약품 진입</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>국내 HDI 업체 프로모션 중</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> </ul>				
	Electro	<ul style="list-style-type: none"> <li>외주를 통한 양산</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Developing</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Developing</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> </ul>				
최종표면처리	Electroless	<ul style="list-style-type: none"> <li>금도금 분야 전세계 1위 점유율 확보 (50%이상)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>고객사 평가중</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Developing</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>일부 국내 고객사 거래중</li> </ul>				
	Electro	<ul style="list-style-type: none"> <li>베트남 시장 전해금도금 외주물량 확대</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Developing</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Developing</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Developing</li> </ul>				

Sales Result

■ 최종표면처리[금도금]      □ 기판가공  
■ 동도금                              □ Process Chemical  
■ 기타 및 장비

(단위:억원)



- **20년 3분기 매출액 332.1억원으로 역대 최대 매출 달성**
  - ✓ 19년 동기대비 매출액 37.2억원 / 12.6% 성장
- **Chemical 제품군의 지속적인 성장**
  - ✓ 최종표면처리 : 중국 시장 카메라모듈용 도금약품의 매출확대 및 북미 고객사 OLED RFPCB 양산 시작
  - ✓ 동도금 : 북미 고객사 OLED RFPCB 양산 시작
  - ✓ Process Chemical : Substrate PKG 고객사 진입으로 인한 전년 동기 대비 매출 상승
- **베트남 법인의 매출 및 이익 확대**
  - ✓ 19년 3분기 23.5억원 → 20년 3분기 93.8억원 성장
  - ✓ 국내 FPCB 고객사의 물량이 베트남으로 이전됨에 따라 베트남 법인의 약품 매출 확대
  - ✓ 베트남 법인 도금사업부 흑자전환

## 신규사업 진행현황

### 소재사업 (동박)

- 현재 폴더블폰 안테나 EMI 차폐용으로 공급 중. 폴더블폰 개화에 따라 향후 매출 확대 전망.
- Main Application 시장인 PKG Substrate 용 극동박은 현재 개발 중으로 현재 해당 시장은 일본 1개 회사 독점 중. 당사는 국책과제 및 소부장 100 선정으로 해당 시장 진입을 위해 제품 개발 중.

### 구리원단

- 당사의 원단은 항균성능, 살균성능, 유해물질 등에 대하여 시험성적서는 모두 획득하였으며, 현재 바이러스에 대한 성능실험을 진행 중에 있음.
- 일부 마스크 제조사들에 원단이 공급되었으며, 고객사는 마스크 제작 후 성적서 발급 중에 있음.
- 현재 성능 시험과 당사의 원가구조 등을 고려하여 사업화를 준비하는 과정으로 구체적인 매출 전망 수립은 이른 단계임.



Income Statement (누적)

(단위:억원)

	제 22기 3분기	매출비중	제 21기 3분기	매출비중
I. 매출액	<b>818.0</b>	100%	683.5	100%
II. 매출원가	<b>521.0</b>	63.7%	421.2	61.6%
III. 매출총이익	<b>297.0</b>	36.3%	262.3	38.4%
판매비와 관리비	<b>109.6</b>	13.4%	91.2	13.3%
IV. 영업이익	<b>187.4</b>	22.9%	171.1	25.0%
금융수익	<b>24.5</b>	3.0%	20.9	3.1%
금융비용	<b>22.4</b>	2.7%	9.1	1.3%
기타수익	<b>6.1</b>	0.7%	8.7	1.3%
기타비용	<b>1.5</b>	0.2%	7.5	1.1%
지분법손익	<b>-1.4</b>	-0.2%	0.1	0.0%
V. 법인세차감전순이익	<b>192.7</b>	23.6%	184.2	26.9%
법인세비용	<b>25.4</b>	3.1%	42.6	6.2%
VI. 당기순이익	<b>167.3</b>	20.5%	141.6	20.7%

주요 수익성 지표

	22기 3분기	21기 3분기
영업이익률	22.9%	25.0%
순이익률	20.5%	20.7%
EBITDA (마진율)	230.6 (28.2%)	206.2 (30.2%)
총자산회전률	47.6%	49.6%

Income Statement (분기)

(단위:억원)

	2020. 3Q	매출비중	2019. 3Q	매출비중
I. 매출액	<b>332.1</b>	<b>100%</b>	<b>294.9</b>	<b>100%</b>
II. 매출원가	206.2	62.1%	181.2	61.4%
III. 매출총이익	125.9	37.9%	113.7	38.6%
판매비와 관리비	37.5	11.3%	37.7	12.8%
IV. 영업이익	<b>88.4</b>	<b>26.6%</b>	<b>76.0</b>	<b>25.8%</b>
금융수익	-1.8	-0.5%	10.7	3.6%
금융비용	8.4	2.5%	3.5	1.2%
기타수익	4.0	1.2%	0.8	0.3%
기타비용	0.4	0.1%	0.4	0.1%
지분법손익	-0.5	-0.1%	0.0	0.0%
V. 법인세차감전순이익	81.3	24.5%	83.6	28.4%
법인세비용	16.9	5.1%	20.5	7.0%
VI. 당기순이익	<b>64.4</b>	<b>19.4%</b>	<b>63.1</b>	<b>21.4%</b>

주요 수익성 지표

	2020. 3Q	2019. 3Q
영업이익률	26.6%	25.8%
순이익률	19.4%	21.4%
EBITDA (마진율)	103.2 (31.1%)	88.6 (30.1%)

## Balance Sheet

(단위:억원)

	제 22기 3분기	제 21기
자산		
현금성자산	509.7	417.5
매출채권	279.6	264.7
유형자산	628.8	608.6
기타자산	377.1	348.5
<b>자산총계</b>	<b>1,795.2</b>	<b>1,639.3</b>
부채		
매입채무	36.3	33.0
차입금	319.9	344.7
전환사채	119.5	140.4
기타부채	143.2	216.9
<b>부채총계</b>	<b>618.9</b>	<b>735.0</b>
자본		
자본금	74.8	37.0
자본잉여금	264.1	218.6
이익잉여금	656.3	531.3
기타자본	181.1	117.4
<b>자본총계</b>	<b>1,176.3</b>	<b>904.3</b>
부채와 자본계	1,795.2	1,639.3

## Cash Flow

(단위:억원)

	제 22기 3분기	제 21기 3분기
기초현금	417.5	276.1
영업활동으로 인한 현금흐름	187.9	95.3
순이익	167.3	141.6
감가상각비	43.2	35.0
대손상각비(환입)	-1.8	-10.8
이자비용	14.2	7.6
법인세비용	25.4	42.6
파생상품평가이익	-12.9	-0.5
자산부채의 변동	-35.1	-92.4
투자활동으로 인한 현금흐름	-84.6	-86.3
유무형자산의 증가	-61.2	-87.2
재무활동으로 인한 현금흐름	-12.4	6.1
자기주식의 처분	21.7	0
차입금 증감	-24.8	19.8
현금증감	90.9	15.1
환율변동효과	1.3	9.0
기말현금	509.7	300.2